

2015年4月28日

2015年3月期 決算説明会

代表取締役社長
山口 悟郎

本日のご説明内容

- 1. 2015年3月期 決算概要**
- 2. 2016年3月期 業績予想**
- 3. 今後の取り組み**

1. 2015年3月期 決算概要

2. 2016年3月期 業績予想

3. 今後の取り組み

2015年3月期 決算概要

(単位：百万円)

	2014年3月期		2015年3月期		増減	
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	金額	率(%)
売上高	1,447,369	100.0%	1,526,536	100.0%	79,167	5.5%
営業利益	120,582	8.3%	93,428	6.1%	-27,154	-22.5%
税引前当期純利益	146,268	10.1%	121,862	8.0%	-24,406	-16.7%
当社株主に帰属する当期純利益	88,756	6.1%	115,875	7.6%	27,119	30.6%
希薄化後EPS(円)	241.93	-	315.85	-	73.92	-
設備投資額	56,611	3.9%	56,670	3.7%	59	0.1%
減価償却費	65,760	4.5%	62,413	4.1%	-3,347	-5.1%
研究開発費	48,830	3.4%	55,285	3.6%	6,455	13.2%
平均為替レート	ドル	100円	110円			
	ユーロ	134円	139円			
為替変動による影響額(前期比)	売上高	約 1,400億円	約 580億円			
	税引前当期純利益	約 290億円	約 70億円			

(注) 希薄化後EPSは、2013年10月1日に実施した株式分割(普通株式1株を2株に分割)を、2014年3月期の期首(2013年4月1日)に実施したと仮定し算出しています。

2015年3月期 事業セグメント別売上高

(単位：百万円)

	2014年3月期		2015年3月期		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	率(%)
ファインセラミック部品関連事業	80,020	5.5%	90,694	5.9%	10,674	13.3%
半導体部品関連事業	187,891	13.0%	217,879	14.3%	29,988	16.0%
ファインセラミック応用品関連事業	272,795	18.9%	277,629	18.2%	4,834	1.8%
電子デバイス関連事業	284,322	19.6%	284,145	18.6%	-177	-0.1%
部品事業 計	825,028	57.0%	870,347	57.0%	45,319	5.5%
通信機器関連事業	186,749	12.9%	204,290	13.4%	17,541	9.4%
情報機器関連事業	307,848	21.3%	332,596	21.8%	24,748	8.0%
機器事業 計	494,597	34.2%	536,886	35.2%	42,289	8.6%
その他の事業	173,137	11.9%	172,925	11.3%	-212	-0.1%
調整及び消去	-45,393	-3.1%	-53,622	-3.5%	-8,229	-
売上高	1,447,369	100.0%	1,526,536	100.0%	79,167	5.5%

部品事業、機器事業ともに増収

2015年3月期 事業セグメント別利益

(単位：百万円)

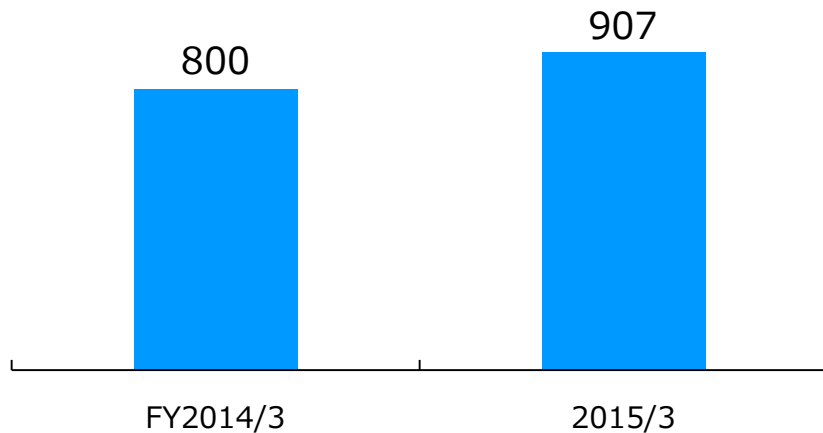
	2014年3月期		2015年3月期		増減	
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	金額	率(%)
ファインセラミック部品関連事業	11,836	14.8%	16,134	17.8%	4,298	36.3%
半導体部品関連事業	31,889	17.0%	33,971	15.6%	2,082	6.5%
ファインセラミック応用品関連事業	33,501	12.3%	3,159	1.1%	-30,342	-90.6%
電子デバイス関連事業	21,160	7.4%	34,372	12.1%	13,212	62.4%
部品事業 計	98,386	11.9%	87,636	10.1%	-10,750	-10.9%
通信機器関連事業	1,437	0.8%	-20,212	-	-21,649	-
情報機器関連事業	28,193	9.2%	34,569	10.4%	6,376	22.6%
機器事業 計	29,630	6.0%	14,357	2.7%	-15,273	-51.5%
その他の事業	6,276	3.6%	6,848	4.0%	572	9.1%
事業利益 計	134,292	9.3%	108,841	7.1%	-25,451	-19.0%
本社部門損益等	11,976	-	13,021	-	1,045	8.7%
税引前当期純利益	146,268	10.1%	121,862	8.0%	-24,406	-16.7%

ファインセラミック応用品及び通信機器関連事業の利益減を主因に減益

2015年3月期 セグメント別業績 －ファインセラミック部品関連事業－

売上高

(単位：億円)

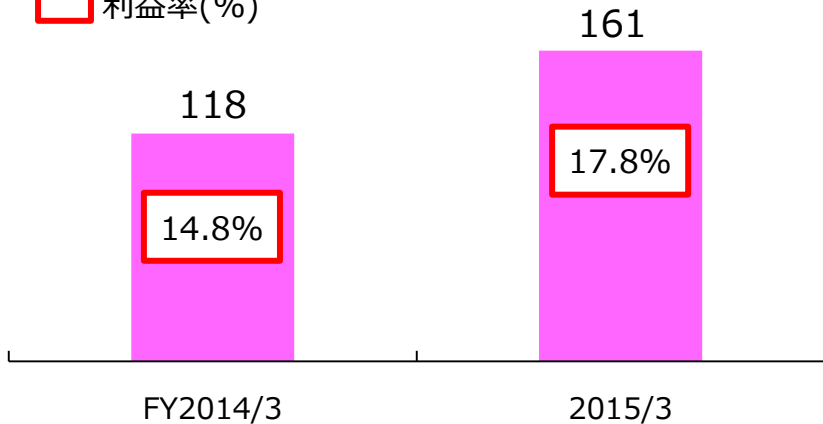


2014年3月期比 増減		
売上高	+107億円	+13.3%
事業利益	+43億円	+36.3%

事業利益

(単位：億円)

利益率(%)



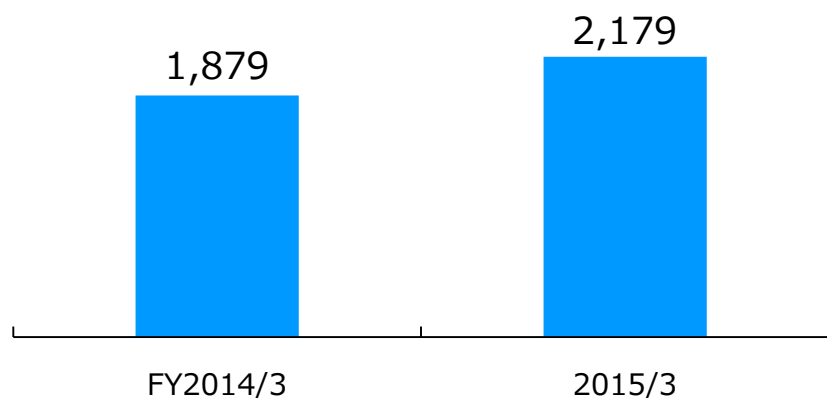
<増減要因>

- ✓ 産業機械向け部品やLED用サファイア基板、並びに車載用カメラモジュール等の売上増
- ✓ 増収及び原価低減効果により事業利益は増加、利益率も向上

2015年3月期 セグメント別業績 －半導体部品関連事業－

売上高

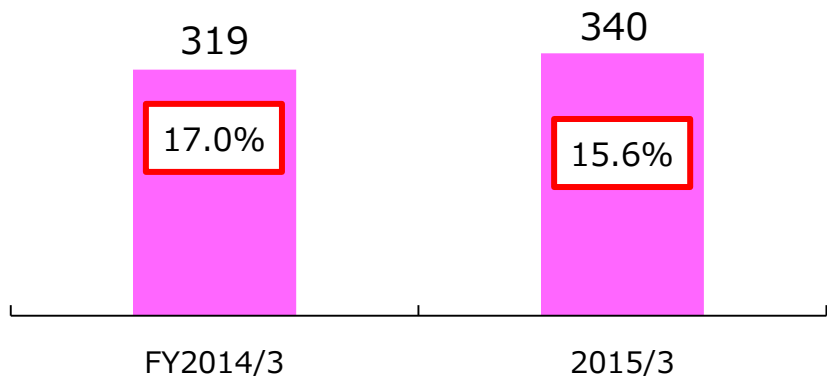
(単位：億円)



事業利益

(単位：億円)

利益率(%)



2014年3月期比 増減

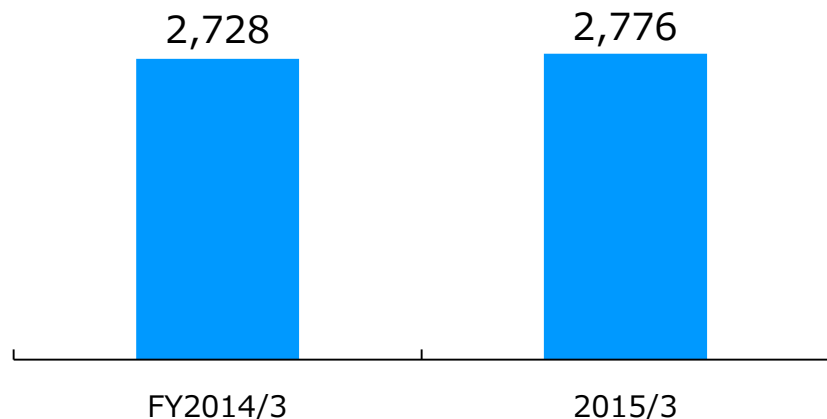
売上高	+ 300億円	+16.0%
事業利益	+ 21億円	+6.5%

<増減要因>

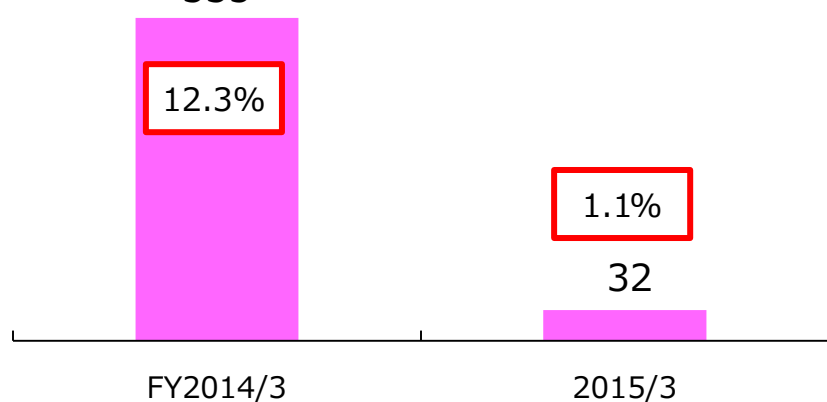
- ✓ スマートフォンや通信インフラ、LED用のセラミックパッケージの売上増、及び2013年10月に連結子会社となった京セラサーキットソリューションズ(株)が通年で寄与し増収
- ✓ 有機事業の新工場立ち上げに伴う費用の増加や製品価格の下落の影響はあったものの、セラミックパッケージの増収及び原価低減効果により増益

2015年3月期 セグメント別業績 － ファインセラミック応用品関連事業 －

売上高 (単位：億円)



事業利益 (単位：億円)



2014年3月期比 増減

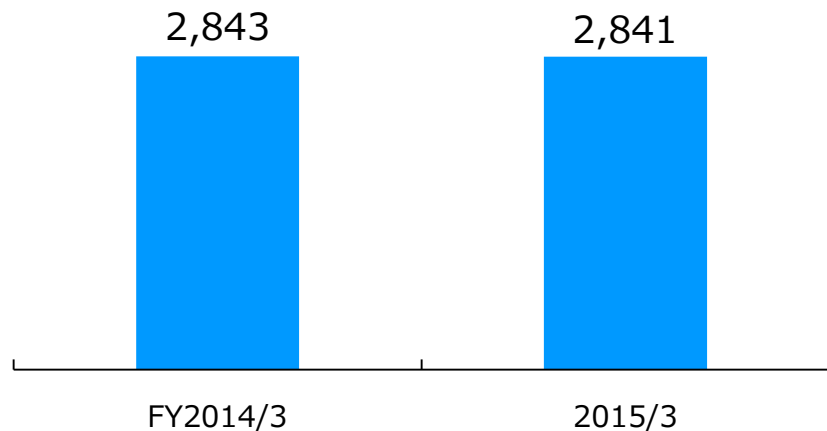
売上高	+48億円	+1.8%
事業利益	▲303億円	▲90.6%

<増減要因>

- ✓ ソーラーエネルギー事業は、価格下落及び一部の電力会社での系統接続保留の影響等により減収
- ✓ 機械工具事業は需要増により増収
- ✓ ソーラーエネルギー事業における価格下落や円安デメリット、並びに資産評価の見直し等の影響により減益

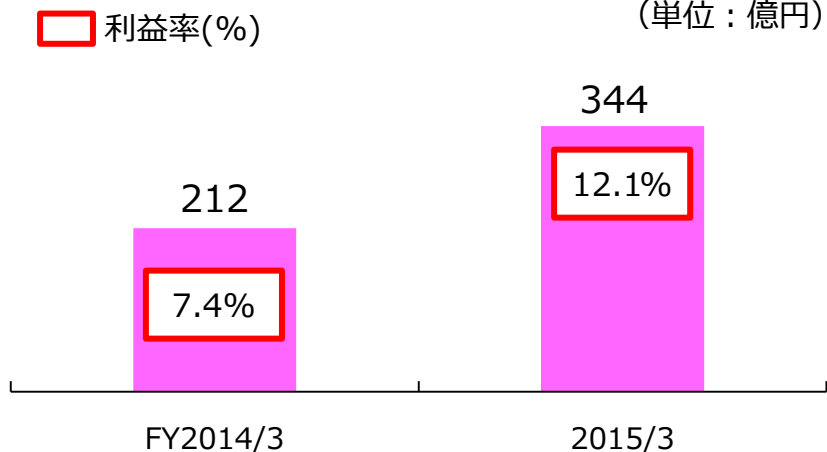
2015年3月期 セグメント別業績 －電子デバイス関連事業－

売上高 (単位：億円)



2014年3月期比 増減		
売上高	▲2億円	▲0.1%
事業利益	+132億円	62.4%

事業利益 (単位：億円)



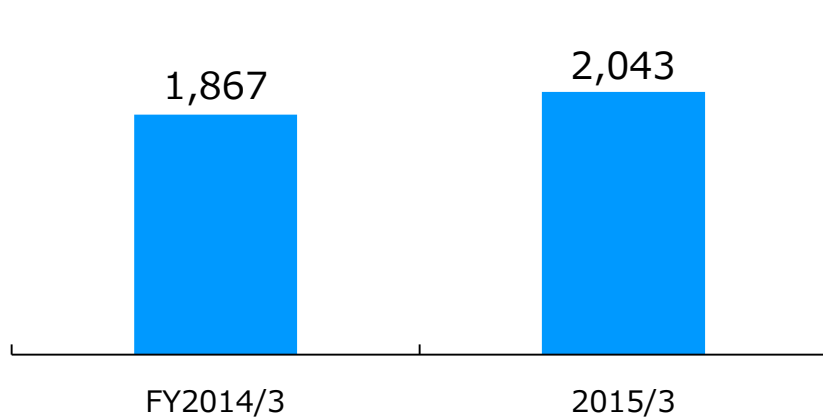
<増減要因>

- ✓ スマートフォン向けコンデンサ、コネクタ、産業機器向けプリンティングデバイスの需要は増加
- ✓ 前期に実施した構造改革に伴う民生用タッチパネル事業の縮小により、セグメント全体では横ばい
- ✓ 原価低減及び構造改革の効果により増益、利益率も改善

2015年3月期 セグメント別業績 －通信機器関連事業－

売上高

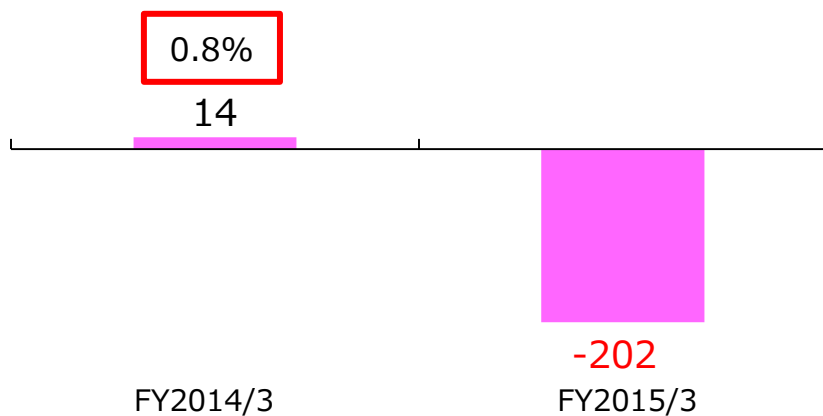
(単位：億円)



利益率(%)

事業利益

(単位：億円)



2014年3月期比 増減

売上高	+176億円	+9.4%
事業利益	▲216億円	-

<増減要因>

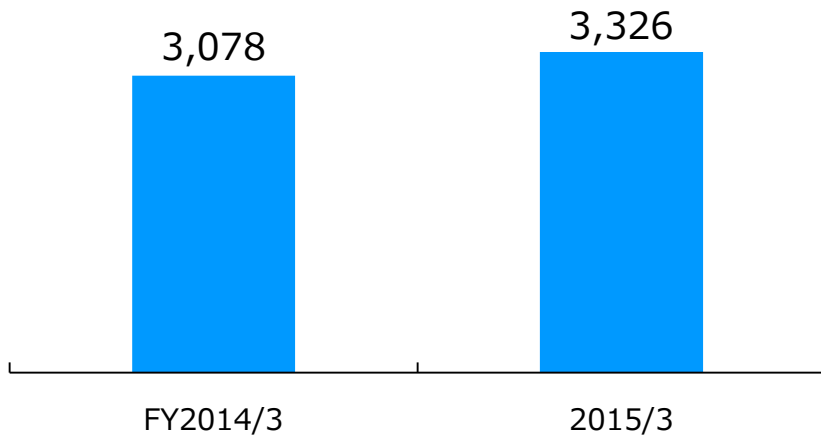
- ✓ スマートフォンの販売増及び海外市場での新規客先開拓による売上増により増収
- ✓ 営業権の減損損失の計上を主因に減益

2015年3月期 セグメント別業績

－情報機器関連事業－

売上高

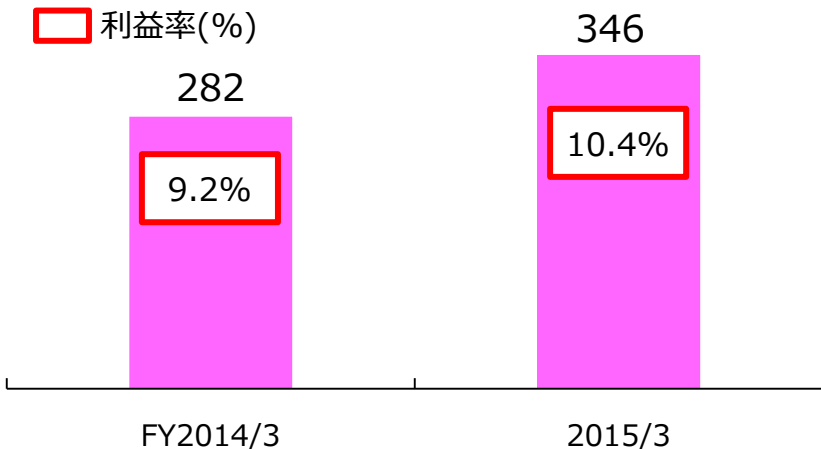
(単位：億円)



事業利益

(単位：億円)

利益率(%)



2014年3月期比 増減

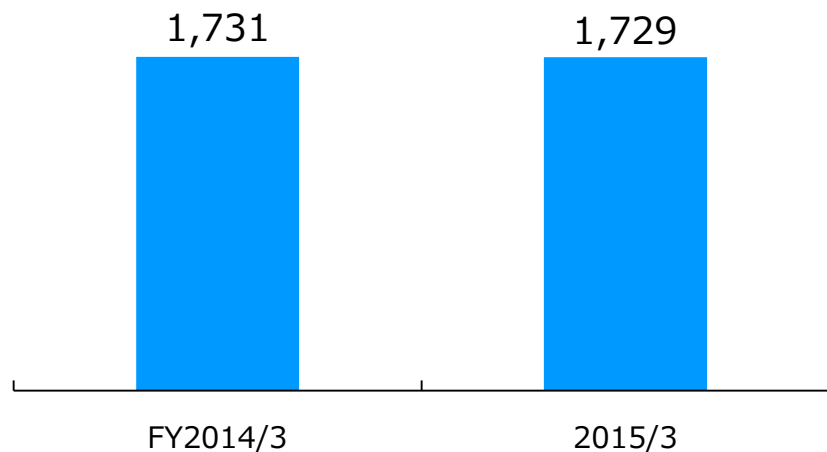
売上高	+248億円	+8.0%
事業利益	+64億円	+22.6%

<増減要因>

- ✓ 欧米及びアジア地域での販売台数の増加による売上増
- ✓ 機器の販売増に伴う消耗品等の売上増及び原価低減効果により増益

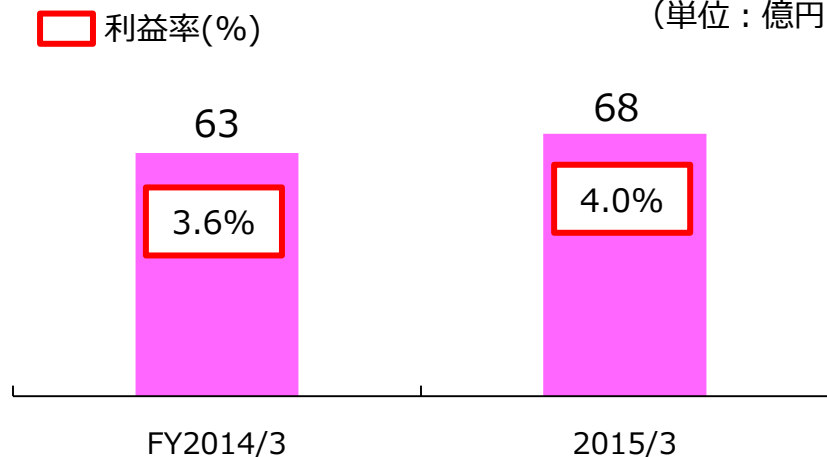
2015年3月期 セグメント別業績 －その他の事業－

売上高 (単位：億円)



2014年3月期比 増減		
売上高	▲2億円	▲0.1%
事業利益	+5億円	+9.1%

事業利益 (単位：億円)



<増減要因>

- ✓ 京セラコミュニケーションシステム(株)の売上は減少したものの、その他子会社の売上増により、セグメント全体の売上高は横ばい
- ✓ 事業利益は原価低減により増益

1. 2015年3月期 決算概要

2. 2016年3月期 業績予想

3. 今後の取り組み

2016年3月期 業績予想

(単位：百万円)

	2015年3月期		2016年3月期予想		増減	
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	金額	率(%)
売上高	1,526,536	100.0%	1,600,000	100.0%	73,464	4.8%
営業利益	93,428	6.1%	160,000	10.0%	66,572	71.3%
税引前当期純利益	121,862	8.0%	184,000	11.5%	62,138	51.0%
当社株主に帰属する当期純利益	115,875	7.6%	120,000	7.5%	4,125	3.6%
希薄化後EPS(円)	315.85	-	327.10	-	11.25	-
設備投資額	56,670	3.7%	70,000	4.4%	13,330	23.5%
減価償却費	62,413	4.1%	74,000	4.6%	11,587	18.6%
研究開発費	55,285	3.6%	60,000	3.8%	4,715	8.5%
平均為替レート	ドル	110円	115円			
	ユーロ	139円	125円			
為替変動による影響額(前期比)	売上高	約 580億円	約 10億円			
	税引前当期純利益	約 70億円	約 ▲80億円			

(注) 2016年3月期予想の希薄化後EPSは、2015年3月期の希薄化後の期中平均株式数を用いて算出しています。

2016年3月期 事業セグメント別売上高予想

(単位：百万円)

	2015年3月期		2016年3月期予想		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	率(%)
ファインセラミック部品関連事業	90,694	5.9%	100,000	6.3%	9,306	10.3%
半導体部品関連事業	217,879	14.3%	248,000	15.5%	30,121	13.8%
ファインセラミック応用品関連事業	277,629	18.2%	247,000	15.4%	-30,629	-11.0%
電子デバイス関連事業	284,145	18.6%	295,000	18.4%	10,855	3.8%
部品事業 計	870,347	57.0%	890,000	55.6%	19,653	2.3%
通信機器関連事業	204,290	13.4%	205,000	12.8%	710	0.3%
情報機器関連事業	332,596	21.8%	360,000	22.5%	27,404	8.2%
機器事業 計	536,886	35.2%	565,000	35.3%	28,114	5.2%
その他の事業	172,925	11.3%	184,000	11.5%	11,075	6.4%
調整及び消去	-53,622	-3.5%	-39,000	-2.4%	14,622	-
売上高	1,526,536	100.0%	1,600,000	100.0%	73,464	4.8%

2016年3月期 事業セグメント別利益予想

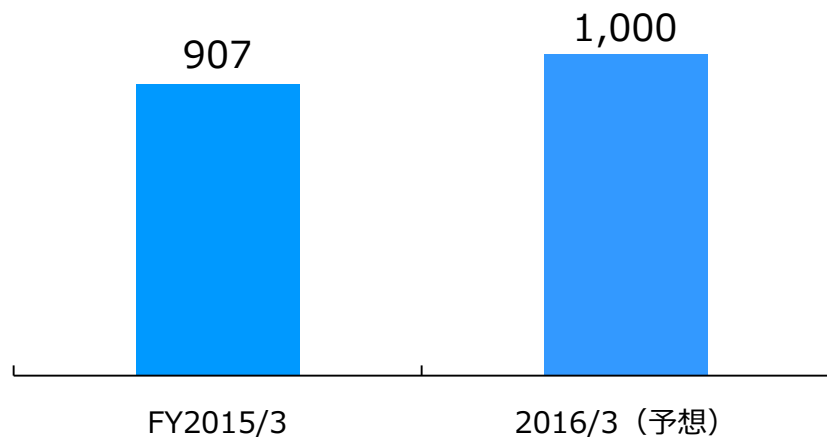
(単位：百万円)

	2015年3月期		2016年3月期予想		増減	
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	金額	率(%)
ファインセラミック部品関連事業	16,134	17.8%	18,000	18.0%	1,866	11.6%
半導体部品関連事業	33,971	15.6%	39,000	15.7%	5,029	14.8%
ファインセラミック応用品関連事業	3,159	1.1%	19,000	7.7%	15,841	501.5%
電子デバイス関連事業	34,372	12.1%	43,000	14.6%	8,628	25.1%
部品事業 計	87,636	10.1%	119,000	13.4%	31,364	35.8%
通信機器関連事業	-20,212	-	3,000	1.5%	23,212	-
情報機器関連事業	34,569	10.4%	36,000	10.0%	1,431	4.1%
機器事業 計	14,357	2.7%	39,000	6.9%	24,643	171.6%
その他の事業	6,848	4.0%	15,000	8.2%	8,152	119.0%
事業利益 計	108,841	7.1%	173,000	10.8%	64,159	58.9%
本社部門損益等	13,021	-	11,000	-	-2,021	-15.5%
税引前当期純利益	121,862	8.0%	184,000	11.5%	62,138	51.0%

2016年3月期 セグメント別業績予想 － ファインセラミック部品関連事業 －

売上高

(単位：億円)

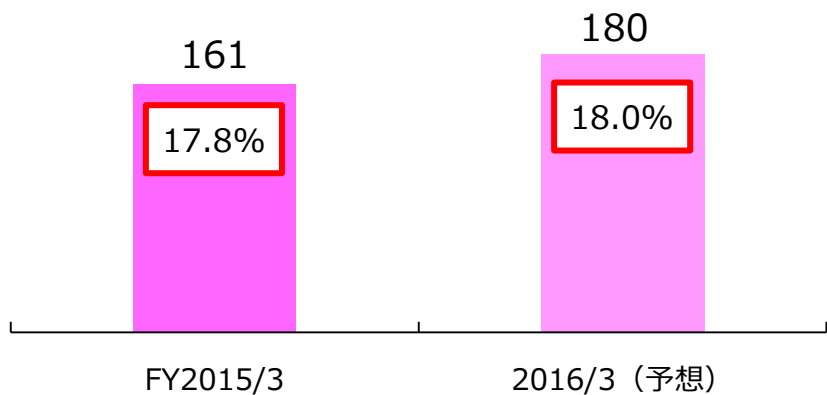


2015年3月期比 増減		
売上高	+ 93億円	+10.3%
事業利益	+ 19億円	+11.6%

事業利益

(単位：億円)

利益率(%)

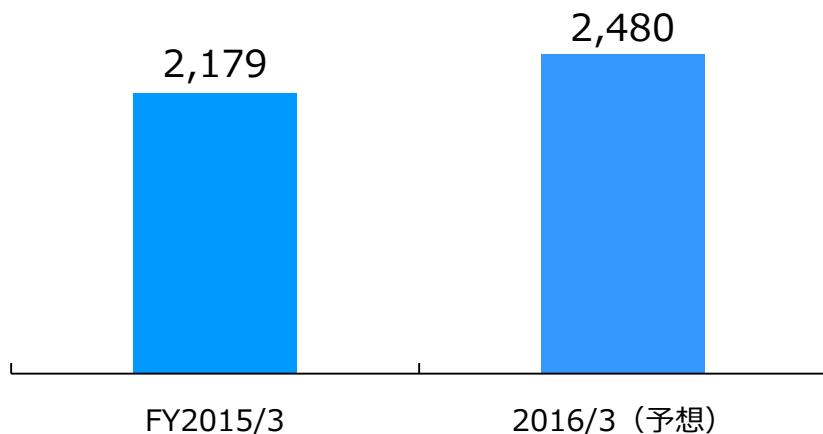


<主な取組み>

- ✓ 半導体製造装置用部品等の産業機械市場向け部品、及び車載用カメラモジュール等の自動車関連部品の売上拡大
- ✓ 主要部品の増収による利益増

2016年3月期 セグメント別業績予想 － 半導体部品関連事業 －

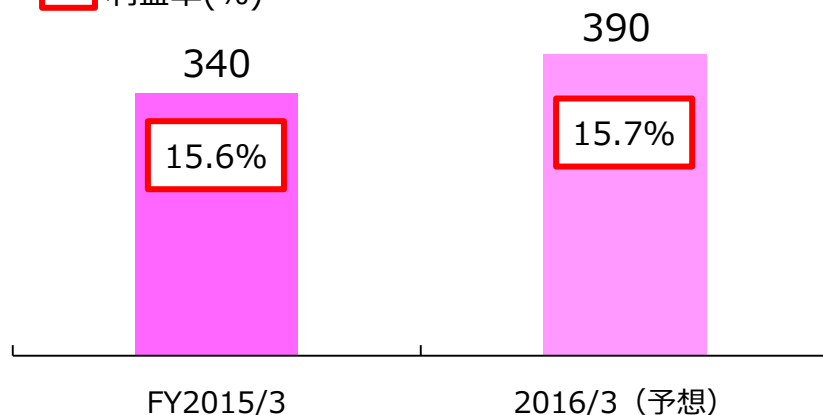
売上高 (単位：億円)



2015年3月期比 増減		
売上高	+ 301億円	+13.8%
事業利益	+ 50億円	+14.8%

事業利益 (単位：億円)

利益率(%)



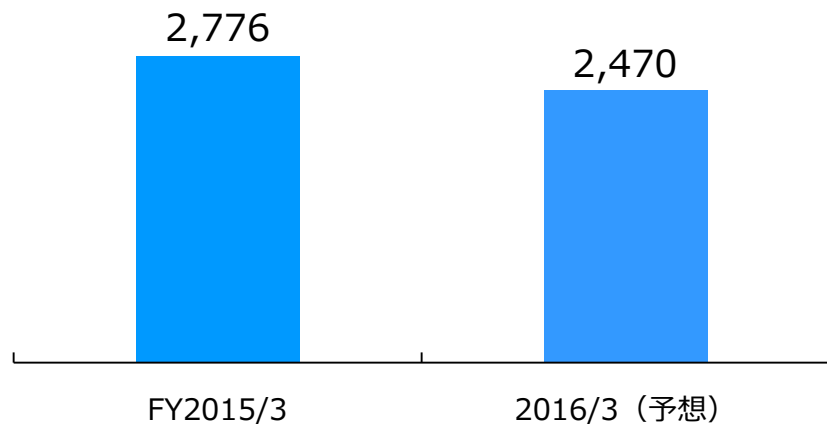
<主な取組み>

- ✓ スマートフォンや通信インフラ市場向けパッケージ・基板の増産及び売上拡大
- ✓ 新工場への有機薄型パッケージの生産集約及び量産効果に加え、セラミックパッケージの増収及びベトナム工場をはじめとした原価低減効果による増益

2016年3月期 セグメント別業績予想 － ファインセラミック応用品関連事業 －

売上高

(単位：億円)

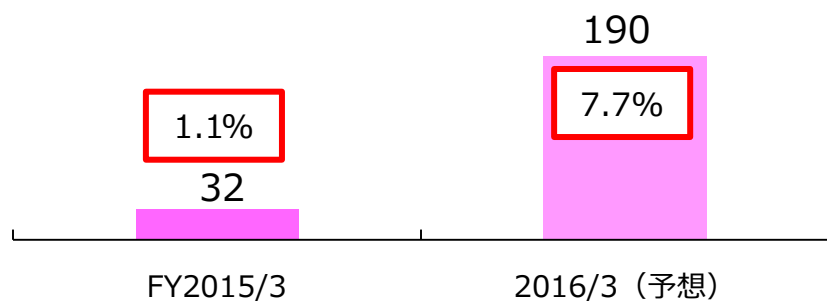


2015年3月期比 増減		
売上高	▲306億円	▲11.0%
事業利益	+158億円	+501.5%

事業利益

(単位：億円)

利益率(%)

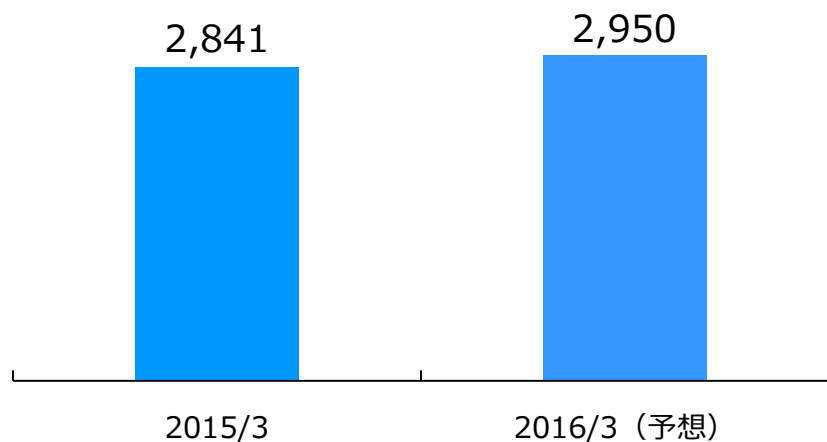


<主な取組み>

- ✓ 機械工具事業の売上は増加するものの、ソーラーエネルギー事業は国内市場の縮小の影響により減収
- ✓ ソーラーエネルギー事業での原価低減及び構造改革費用の減少、機械工具事業の増益による利益改善

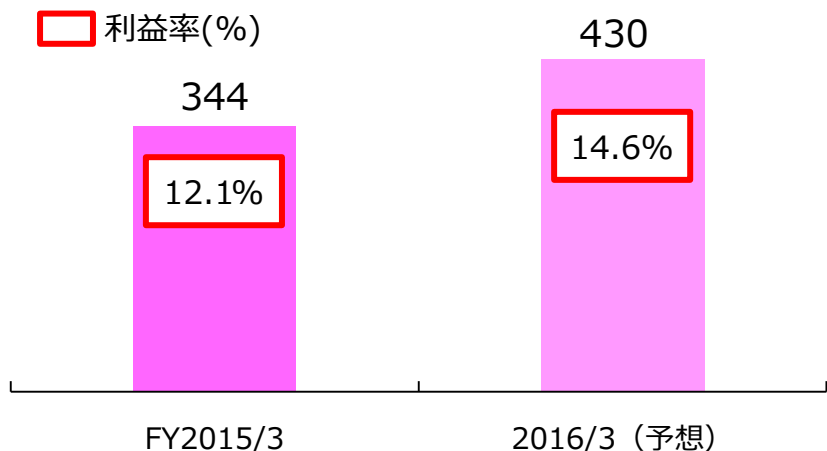
2016年3月期 セグメント別業績予想 － 電子デバイス関連事業 －

売上高 (単位：億円)



2015年3月期比 増減		
売上高	+109億円	+3.8%
事業利益	+86億円	+25.1%

事業利益 (単位：億円)



<主な取組み>

- ✓ スマートフォン向け部品の生産増及びシェアアップ、プリンティングデバイスの売上増による増収
- ✓ 増収効果及び生産性向上による収益性の向上

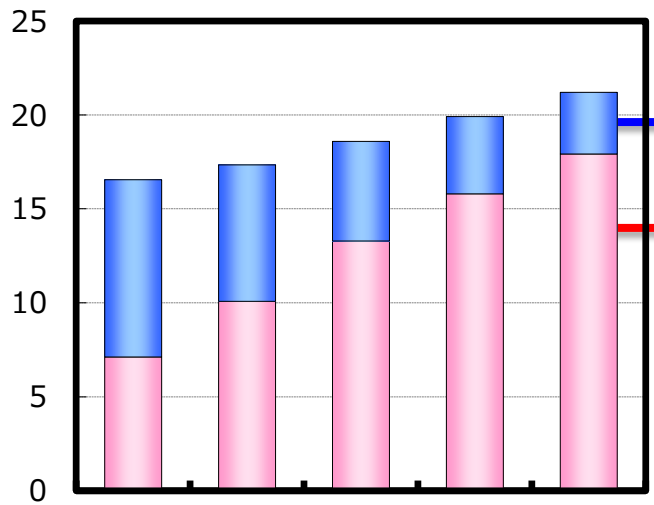
スマートフォン向け部品事業の拡大

通信端末市場



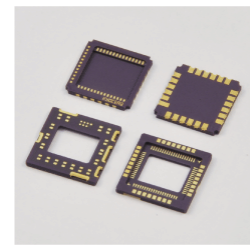
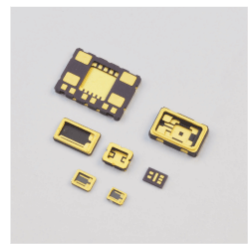
2016年3月期
売上計画
+約30%
(前期比)

(億台) 世界の端末販売台数予想



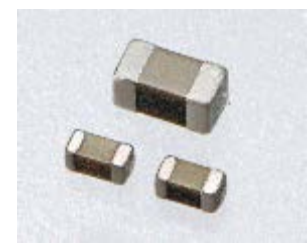
フィーチャーフォン
スマートフォン

(出典：当社推定)



各種セラミック
パッケージ

+約30%



セラミックコンデンサ

+約40%



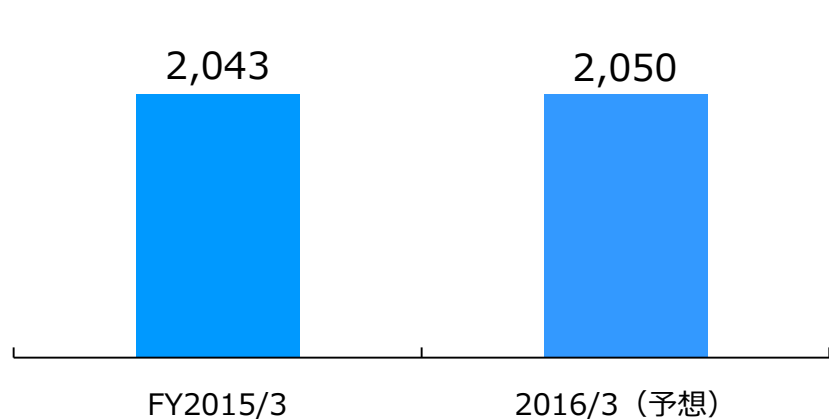
水晶部品

+約70%

2016年3月期 セグメント別業績予想 －通信機器関連事業－

売上高

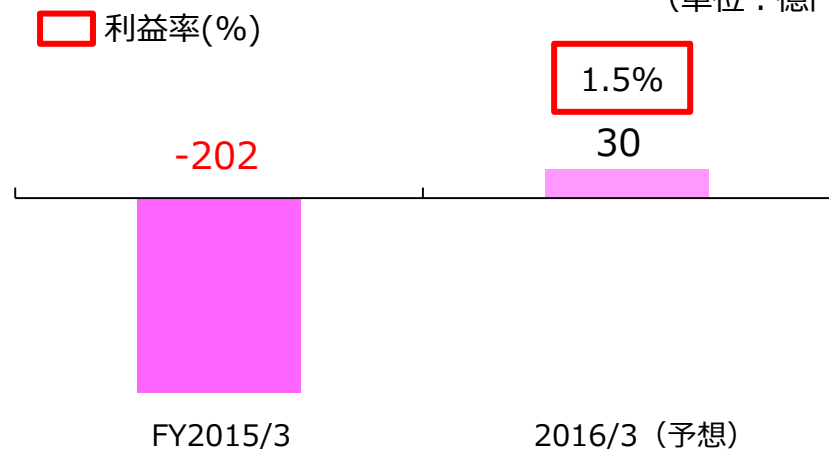
(単位：億円)



2015年3月期比 増減		
売上高	+7億円	+0.3%
事業利益	+232億円	－

事業利益

(単位：億円)



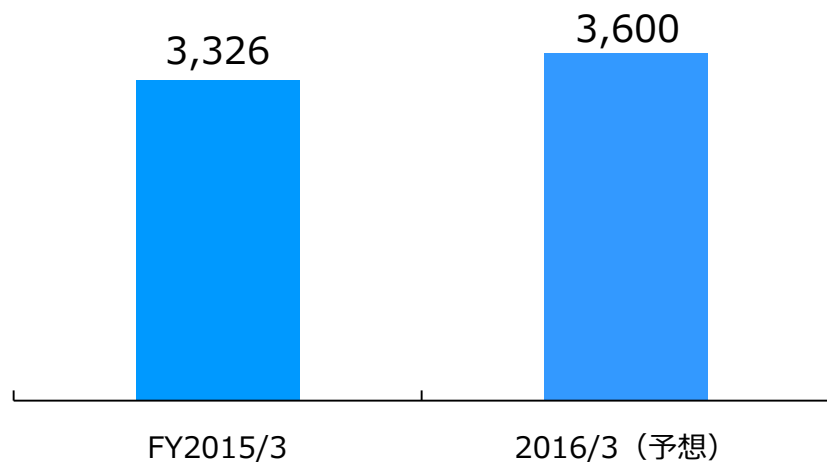
<主な取組み>

- ✓ 国内市場向け商品ラインアップの拡充及び海外での販路拡大
- ✓ 増収効果及びプラットフォーム共通化等を通じた原価低減により増益

2016年3月期 セグメント別業績予想

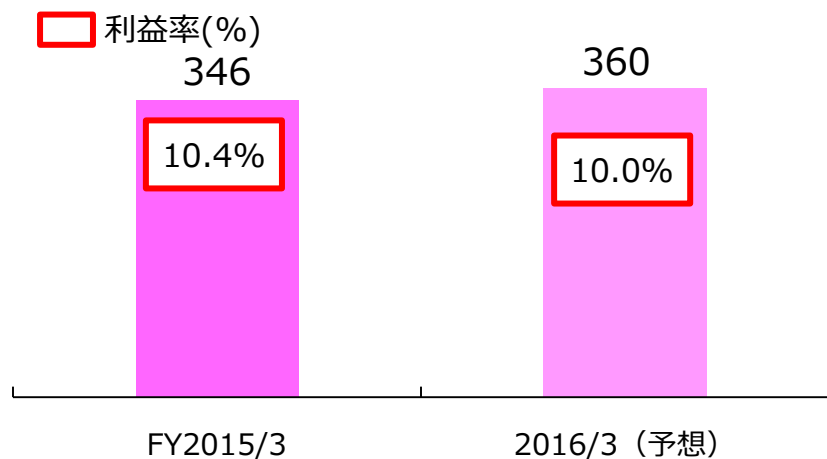
－情報機器関連事業－

売上高 (単位：億円)



2015年3月期比 増減		
売上高	+274億円	+8.2%
事業利益	+14億円	+4.1%

事業利益 (単位：億円)

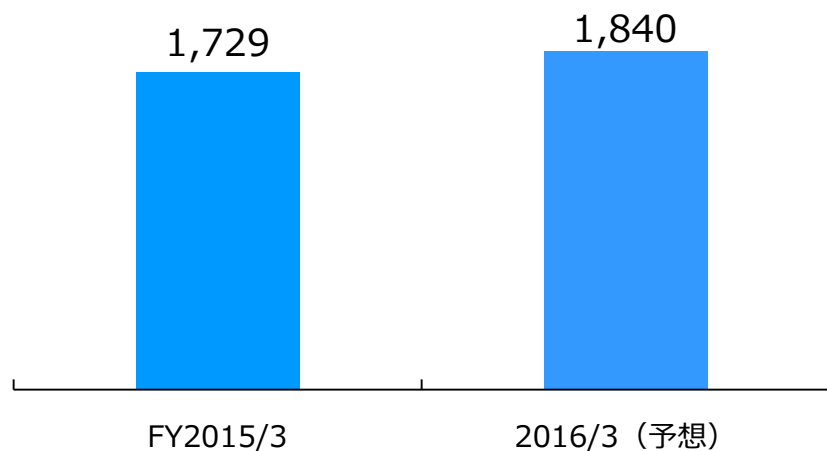


<主な取組み>

- ✓ 新製品投入によるラインアップの拡充及び新興国を中心とした機器の販売拡大
- ✓ 増収及びベトナム工場での原価低減の推進により増益

2016年3月期 セグメント別業績予想 －その他の事業－

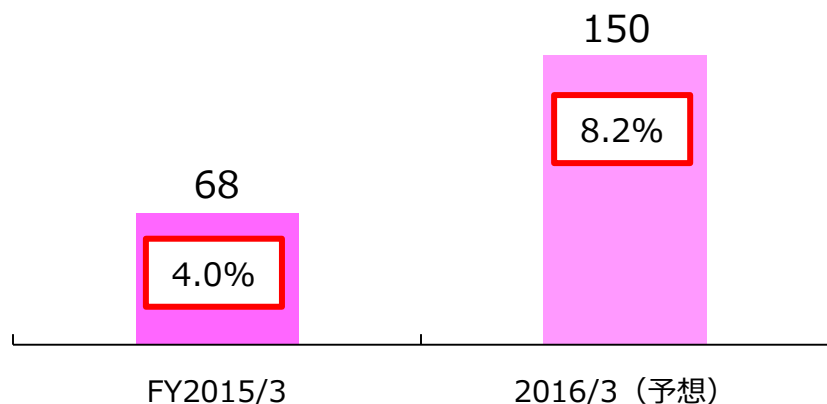
売上高 (単位：億円)



2015年3月期比 増減		
売上高	+111億円	+6.4%
事業利益	+82億円	+119.0%

事業利益 (単位：億円)

利益率(%)



<主な取組み>

- ✓ 京セラコミュニケーションシステム(株)を中心とした売上拡大
- ✓ グループ各社での利益増及び資産売却益等の計上により大幅増益

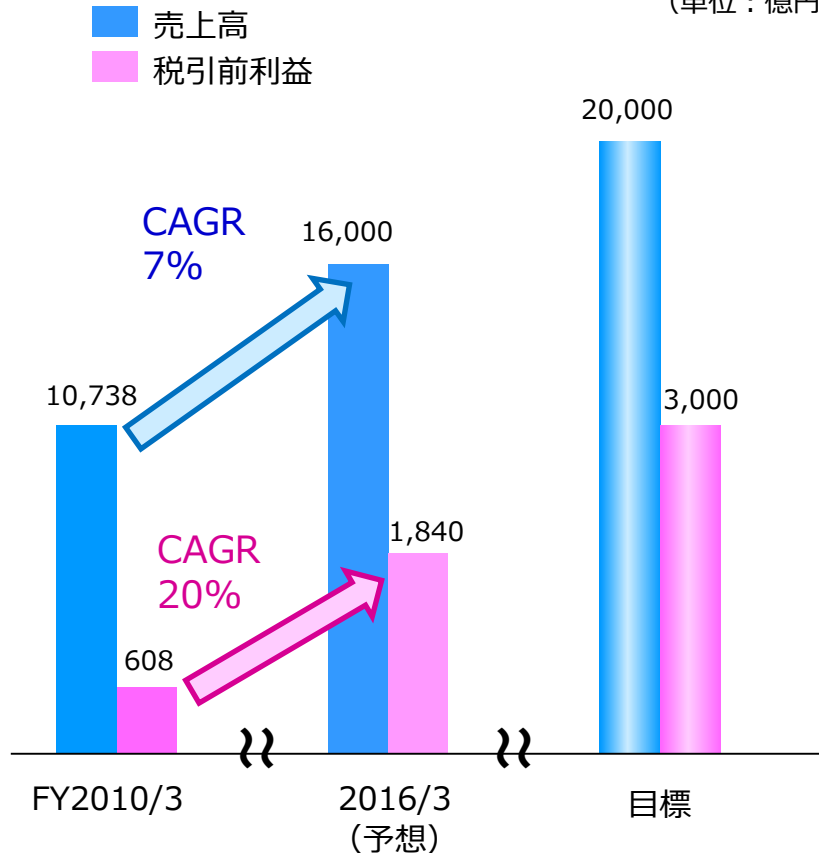
1. 2015年3月期 決算概要
 2. 2016年3月期 業績予想
 - 3. 今後の取り組み**
-

京セラグループの目標

「高成長・高収益企業」を目指す

－売上高・税引前利益の成長率－

(単位：億円)



企業成長のスピードアップ

- 成長分野でのM&Aを含めた事業投資の拡大
- グループ総合力の発揮

重点市場での
事業拡大

経営基盤の
強化

重点市場での事業拡大

4つの重点市場

情報通信

自動車関連

環境・エネルギー

医療・ヘルスケア

既存事業の
売上拡大

徹底した
原価低減

新規事業の
創出

成長のスピードアップを図る

2015年4月より新規事業創出に向け、社長直轄組織を新設

車載関連事業

EMS関連事業

情報通信市場での売上拡大

情報通信市場

IOT

ネットワークを支える基幹部品の展開



スマートグリッド



M2Mモジュール

+



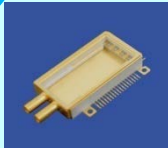
クラウド



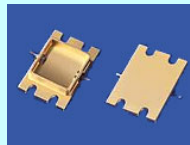
セキュリティ



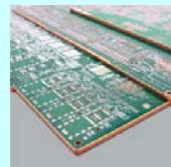
ヘルスケア



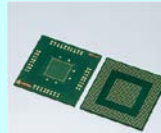
光通信用部品



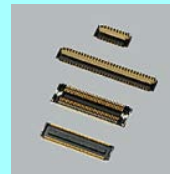
無線通信用
セラミックパッケージ



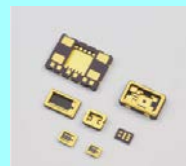
サーバー/ルーター用
高多層プリント配線板



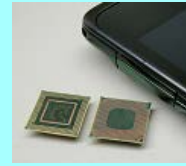
FCBGA基板



コネクタ



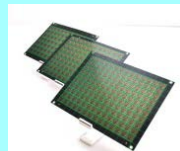
SMDパッケージ



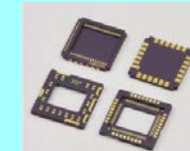
FCCSP基板



SAWデバイス



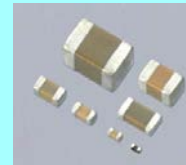
モジュール基板



イメージセンサ用
パッケージ



LED用パッケージ



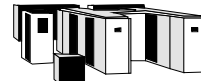
MLCC



サーミスタ付
水晶振動子

通信インフラ

高速通信を様々な部品でサポート



サーバー、ルーター



クラウド

携帯端末/ 情報機器

- ・高付加価値製品の供給
- ・差別化機器の投入



スマートフォン



ウェアラブル
端末

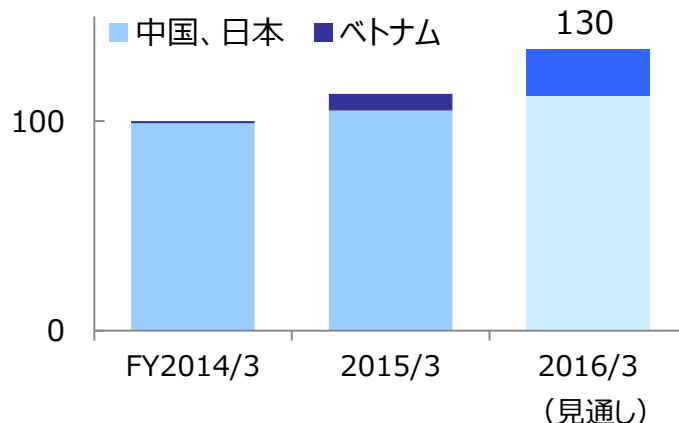


複合機

部品事業での生産拡大

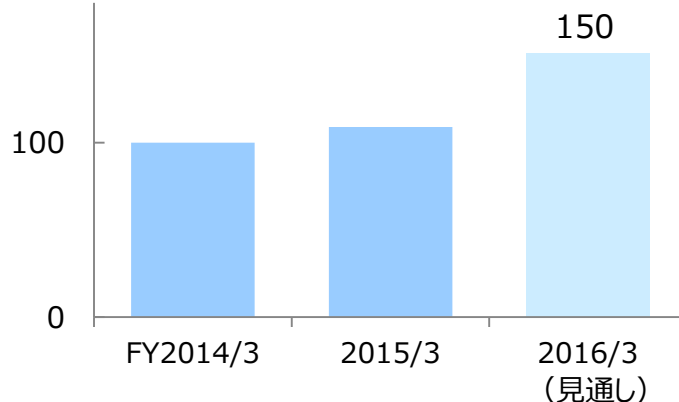
SMDパッケージの生産数量見通し

2014年3月期を100として表示



セラミックコンデンサの生産数量見通し

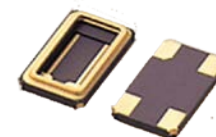
2014年3月期を100として表示



2016年3月期 スマートフォン向け部品の増産計画

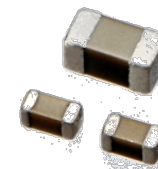
【半導体部品関連事業】

- ・ SMDパッケージ (ベトナム工場)
- ・ LED用パッケージ (国内工場)



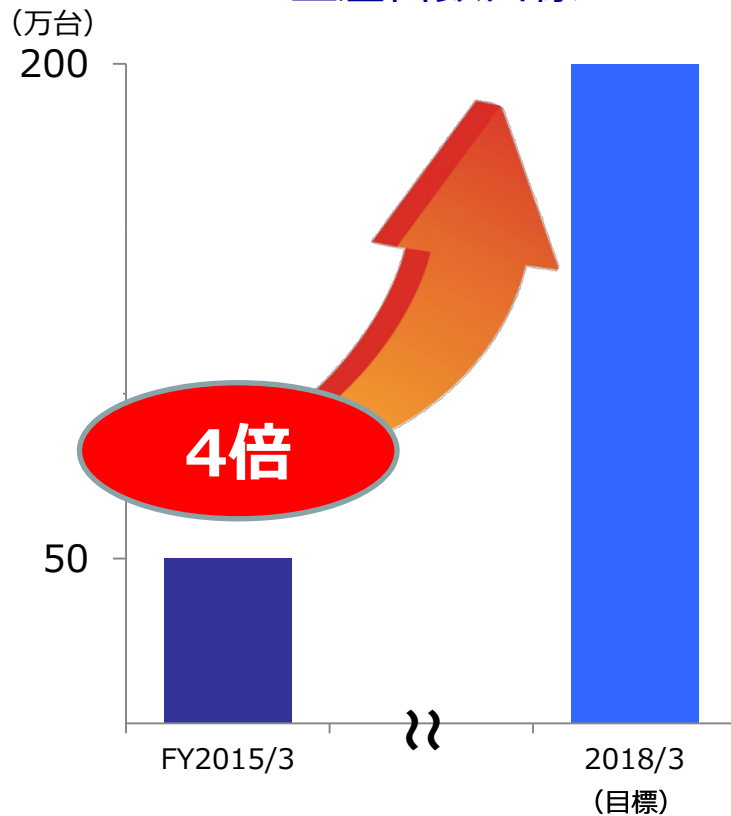
【電子デバイス関連事業】

- ・ セラミックコンデンサ (国内工場)
- ・ コネクタ (ベトナム工場)



情報機器事業での生産拡大

ベトナムでの情報機器の
生産台数目標



ベトナム工場拡大計画 (目標)

【2018年3月期】

- ・ 生産能力：年200万台
(2015年3月期比4倍)
- ・ 従業員数：約5,000人
(2015年3月期比3倍)



自動車関連市場での売上拡大

インフォテイメント対応

高度な情報処理及び自動運転を支える製品ラインアップの拡充



通信モジュール



ミラーディスプレイ



タッチハプティクス



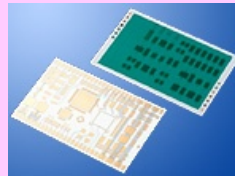
センターインフォメーション
ディスプレイ



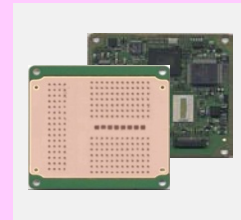
ヘッドアップディスプレイ



メーター



ECU用セラミック
多層基板



ミリレーダー用
アンテナ基板



遠赤外線用レンズ



カメラモジュール

安全性対応

北米での法規制化、
欧州での安全基準強化に
適した製品展開

環境・省エネ対応

排ガス抑制、燃費向上
に貢献する部品展開



ピエゾ素子



グロープラグ



O₂センサー用ヒーター



LEDヘッドライト用
パッケージ

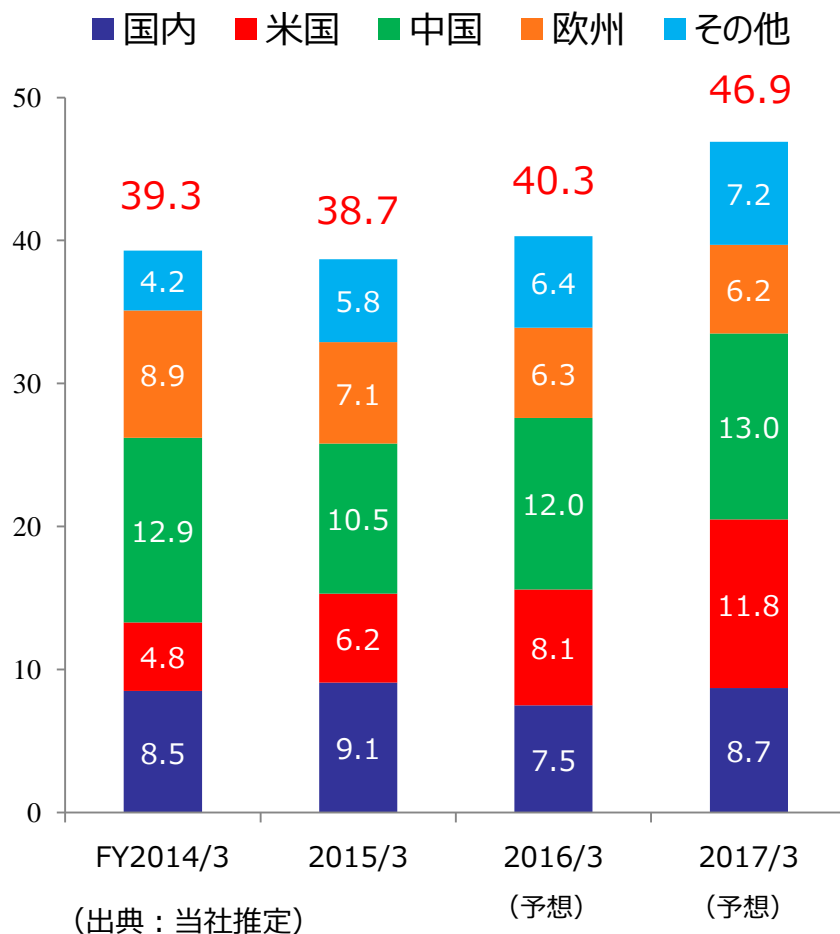


水素製造装置用モジュール

環境・エネルギー市場での事業展開

太陽電池出荷量の推移

(単位：GW)



ソーラーエネルギー事業の取り組み

- 商品の長期信頼性、会社の財務安定性を強みとした受注拡大
- 米国市場での積極的な事業拡大
- 太陽光発電事業での多角化推進により収益拡大
- 徹底した原価低減、性能及び生産性向上による収益性の改善

環境・エネルギー市場での売上拡大

環境・エネルギー市場

アグリゲーションサービス
自動デマンドレスポンス
実証実験展開中



- ・ 出力制御
- ・ 集電サービス
- ・ バッテリー保守サービス

【公共・産業用】
事業機会の獲得



水上メガソーラー発電所

【発電事業】



燃料電池システム
(開発中)



集合住宅、商業施設向け
SOFC燃料電池

【住宅用トータルソリューションビジネス】



住宅用太陽光発電システム



BEMS
ビル・エネルギーマネジメントシステム

HEMS
ホーム・エネルギーマネジメントシステム

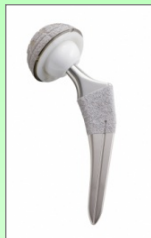


医療・ヘルスケア市場での売上拡大

医療

インプラント事業

人工関節

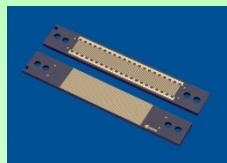


人工歯根



医療機器関連

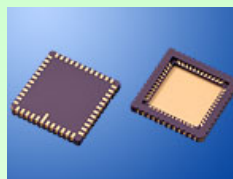
CT



CT用アルミナ基板

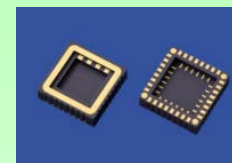
内視鏡

医療用カメラ/
医療機器



イメージセンサ用
セラミックパッケージ

除細動器



超小型
セラミックパッケージ



タンタルコンデンサ



診断用モニタ

ヘルスケア

生活習慣病予防関連事業

ヘルスケア端末

医療・ヘルスケア市場

配当金の推移

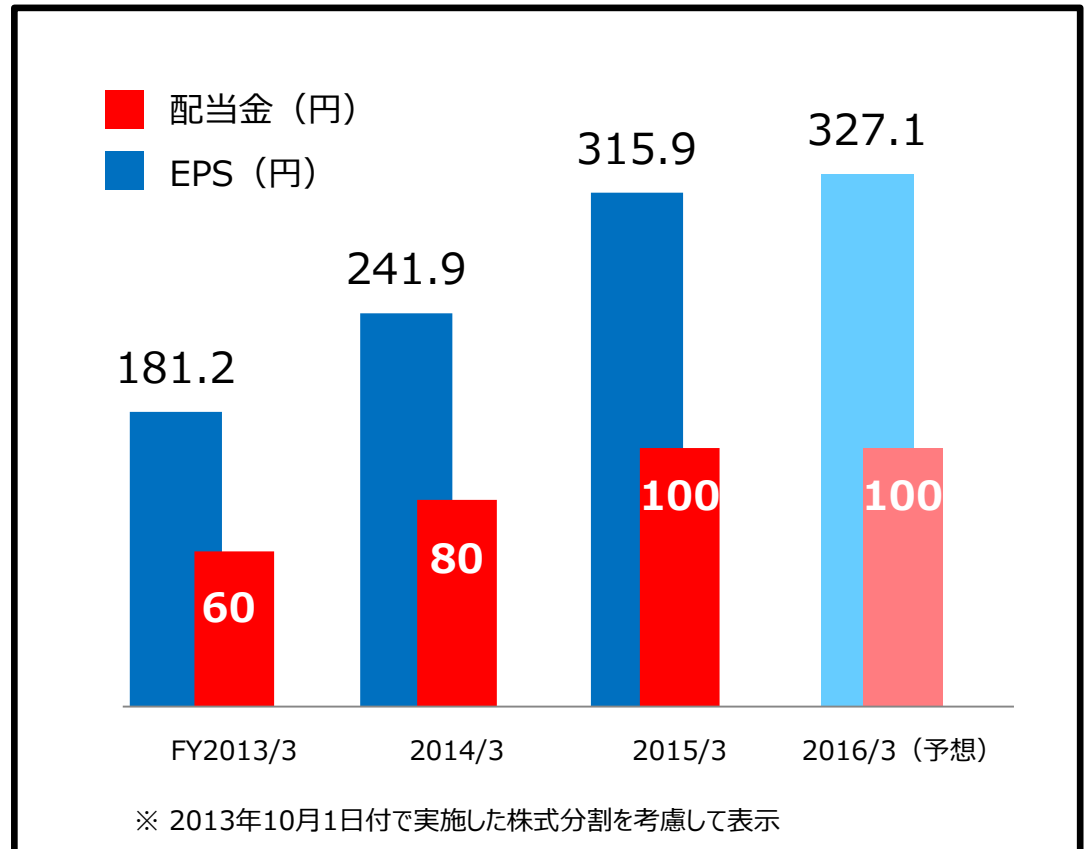
事業成長を通じた
1株当たり利益の増加



1株当たり配当金の増加

配当方針

目標配当性向
30%以上



将来予想に関する注意事項

この資料の記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(Forward-Looking Statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものです。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 日本及び世界経済の停滞による当社製品の需要の減退
- (2) 当社が事業を行う国及び地域における経済・政治・法律面の諸条件及びその想定外の変化
- (3) 円高、政治・経済情勢、関税及び不十分な知的財産権等の保護等が当社製品の輸出に及ぼす影響
- (4) 為替レートの変動が当社の海外資産の価値又は事業活動に及ぼす影響
- (5) 製品価格、技術革新、製品開発、品質、納期等の面における競争の激化
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 電力不足や電力費の上昇が当社の生産活動及び販売活動に及ぼす影響
- (8) 生産及び開発能力の拡大又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態
- (9) 買収した会社又は取得した資産から期待される成果や事業機会が得られない事態
- (10) 科学技術分野等の優れた人材の確保が困難となる事態
- (11) 当社の企業秘密が漏洩又は知的財産権が侵害される事態
- (12) 当社が知的財産権侵害に関連する要求又は特許実施許諾料の請求を受ける可能性
- (13) 国内外の環境規制による賠償責任の発生及び関連費用の負担
- (14) 意図しない法規制への抵触又は想定していない法規制の変更や導入が当社の事業活動を制約する状況
- (15) 疾病の発生、テロ行為、国際紛争等が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす悪影響
- (16) 地震等の自然災害及びこれに付随する災害によって当社の事業関連施設、サプライヤー及び顧客、並びに社会資本及び経済基盤等が甚大な被害を受ける事態
- (17) 当社の顧客の財政状態の悪化により売掛債権の回収が困難となる事態
- (18) 当社が保有する投資有価証券等の時価の下落に伴う減損処理の可能性
- (19) 当社の長期性資産、営業権、無形資産の減損処理の可能性
- (20) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (21) 会計基準の変更

これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。